称重仪表电路设计中的电平兼容

□上海耀华称重系统有限公司 李虎

【摘 要】本文介绍了物联网时代称重仪表电路设计中电平兼容的重要性,以及一些电平兼容电路的设计分析。除此之外,还有本人的一些实践经验分享。

【关键词】物联网; 称重仪表; 电平兼容

文献标识码: B 文章编号: 1003-1870 (2023)06-0023-03

引言

随着物联网的迅速发展,一些无线模块行业已然崛起,同时也让各行各业乘着物联网时代的春风发展壮大。计量行业也奋勇赶超,取得了累累硕果。对硬件设计而言,物联网模块加入到传统仪表中,通信电路的设计就必然会面对电平兼容的问题。如果电平兼容这个问题处理不好,MCU与物联网模块通信跟不上,或者发送接收中出现乱码,部分数据正常,部分数据乱码,当然也有全部乱码的,故电平兼容在电路设计中尤为重要。

1 常见的几种电平信号

1.1 TTL 电平

TTL集成电路的全名是晶体管—晶体管逻辑集成电路(Transistor- Transistor Logic)。它是由双极型晶体管构成,静态功耗相对较大,是电流驱动型器件。TTL电平的高和低的逻辑判断是固定的。输出电平标准:低电平L<0.8V,高电平H>2.4V;输入电平标准:低电平L<1.2V,高电平H>2.0V。TTL电路不使用的输入端悬空为高电平^[5]。

1.2 COM 电平

CMOS 集成电路的全名为互补对称金属氧化物 半 导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor),电路的许多基本逻辑单元都是用增强型PMOS。

晶体管增强型NMOS 晶体管是按照互补对称形式 连接的,静态功耗很小,是电压驱动型器件。CMOS 电平的高和低的逻辑判断是和CMOS 电路的供电电压有关的。CMOS 电路供电电压VCC 是宽范围的,在5V-15V 均能正常工作。COM 电平标准:低电平L<0.1VCC,高电平H>0.9VCC;输入电平标准:低电平L<0.3VCC,高电平H>0.7VCC。CMOS 电路不使用的输入端不能悬空,否则或造成逻辑混乱^[5]。

1.3 RS232 电平

RS232 电 平 标 准: 逻辑1, -3V~-15V; 逻辑 0, +3V~+15V, 电平反相一次。RS232 的逻辑电平 和TTL 不一样但是协议是一样的[5]。一般都是使用 RS232 接口芯片,将UART 接口TTL 电平转换成232 电平^[6]。

1.4 RS485 电平

RS485 是一种串口接口标准, 半双工(逻辑1: +2V—+6V 逻辑0: -2V—-6V)这里的电平指AB两线间的电压差。为了长距离传输采用差分方式传输,传输的是差分信号,即通过AB两根线的电压差作为电平信号。差分信号能有效地抵御外界因素的干扰,因为干扰对两根线影响是一样的,两根线的电压差不变,信号传递也就不会受干扰。与TTL、RS232 只能一对一连接不同,RS-485 在总线上是允许连接多达128 个收发器^[5]。和RS232 接口同理,一般都是使用RS485 接口芯片,将UART 接口TTL 电平转换成RS485 电平^[6]。

而在称重仪表电路系统中,单片机和无线模块的通信接口一般都是UART接口,且系统也都会存在

着混合电压的情况^[3],故电平兼容技术的应用意义很大。

2 常见的无线模块和电平兼容方法

2.1 蓝牙, WIFI, 2G, 4G, LORA 等无线模块是称重行业最为常用的。其中2G 现在要慢慢地退出历史舞台了,取而代之的是4G+2G 的CAT1 模块,兼容2G 频带,且价格相对便宜。这些模块多数都是用UART 接口和单片机通信,也有少数的因为数据速率问题需要使用USB 接口通讯。对于大多数的情况,UART 的数据速率完全满足称重行业的需求,故电平兼容的重要性显得尤为凸出。

2.2 电平兼容方法:

- (1) 在UART 的TX 与RX 串接电阻的方法,这种方法比较经济实用。
- (2) MOS 管或者三极管搭建的电路,主要还是 利用它们的饱和状态开关原理。
- (3)逻辑芯片74xHCT系列芯片,凡是输入与5VTTL电平兼容的5VCMOS器件都可以用作3.3V→5V电平转换。这是由于3.3VCMOS的电平例好和5VTTL电平兼容(巧合)^{[1][2]},而CMOS的输出电平总是接近电源电平的。廉价的选择如74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/······)系列(字母T表示TTL兼容)。
- (4)专用的电平兼容芯片,目前也有很多。国内品牌的有润石和艾为等。
- (5)使用隔离芯片也是一种电平兼容的手段。输入和输出可以共用GND, VCC使用对应电平的电源,这样就可以使两侧的电平兼容。隔离芯片的品牌,还有通道数量都可以选择,而且磁隔离、容隔离、光隔离都是比较成熟的技术。

3 电平兼容的案例

3.1 MOS 管搭建的电平兼容电路

如图1 所示, TXD1 与RXD1 是5V 的TTL 电平, 一般是MCU 硬件接口, 而一些无线通讯模块大多数都是3.3V 供电, 其UART 接口TXD2, RXD2 都是3.3V 的TTL。根据MOS 管在开关状态下的导通条件, Vgs>Vgs(th) 时MOS 导通^[1]。下面就对图1 电路的工作进行具体解释。

MCU 的TXD1 为高电平时,Q1 不导通,RXD2 为高电平;当TXD1 为低电平,通过寄生二极管的连通,RXD2 为低电平,二极管是P->N 导通,N->P 截止。

无线模块的TXD2为高电平时,Q2不导通,RXD1为高电平; 当TXD2为低电平时, Vgs>Vgs(th),Q2导通,RXD1为低电平。

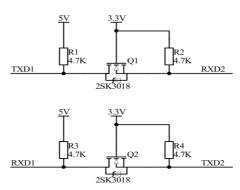


图1 MOS管搭建的电平兼容电路

3.2 三极管搭建的电平兼容电路

如图2 所示,TXD1 与RXD1 是5V 的TTL 电平,TXD2,RXD2 是3.3V 的TTL 电平。和MOS 管搭建的电平兼容电路运用的原理差不多,这个电路运用的是三极管在饱和状态下的开关原理[1]。下面就图2 电路进行分析。

当TXD2(默认为高电平)为高电平时,Q1导通,Q2的基极被拉低,Q2截止。RXD1被R3上拉,

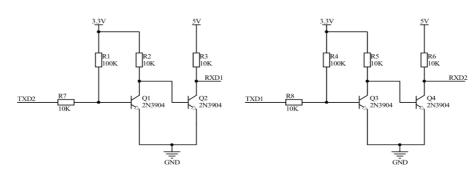


图2 三极管搭建的电平兼容电路

此时RXD1(默认为高电平)为高电平;当TXD2为低电平,Q1截止,Q2的基极仍然为高,Q2导通,此时RXD1通过O2接到GND,为低电平。

当TXD1(默认为高电平)为高电平时,Q3导通,Q4的基极被拉低,Q4截止。RXD1被R6上拉,此时RXD1(默认为高电平)为高电平;当TXD1为低电平,Q3截止,Q4的基极仍然为高,Q4导通,此时RXD2通过Q4接到GND,为低电平。

3.3 隔离芯片搭建的电平兼容电路

如图3 所示电路,使用的是国产的容隔离芯片U2。这个电路没有使用该芯片的隔离功能,仅使用了容隔离两端不同电源供电,通道电平根据供电不通而不同。例如在U2 左侧,TXD1 和RXD1 都是5V的TTL 电平; U2 的右侧,BT_TXD1,BT_RXD1 都是3.3V的TTL,这样就实现了电平兼容的目的。

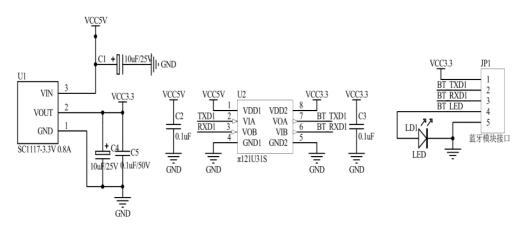


图3 隔离芯片搭建的电平兼容电路

3.4 专用的电平兼容芯片

专用的电平兼容芯片国内国外品牌的都有很多,比如TI公司的可配置电压转换的双电源总线收发器^[4]SN74LVC2T45,同一功能的Microchip公司也有相应的收发器,还有TI公司的电平转换器TXS0108EPWR等。国内品牌的有润石的RS0102,上海艾为电子技术有限公司的AW39102等。

4 实践案例

案例1 在设计其中一种物联网称重仪表调试中,曾经遇到过因为UART 的电平兼容问题导致数码管不显示的现象。这款仪表做的是2G 物联网通讯,MCU是合泰的一款MO核,32位的单片机。当时为了查找问题,做了大量的监测工作。捕捉瞬间的DCDC电源波动情况,和数码管驱动芯片的SPI信号。电源无足够大波动,使得单片机失去作用。后来在尝试找问题的时候,拔掉2G 模块,发现这个数码管突然不显示的现象消失了。通过这个现象再通过程序的在线调试,MCU 就是在与2G 模块进行交互数据时,那个现象才出现。经过查阅2G 模块和MCU 的资料,着重分析 2G 模块的UART 接口能兼容2.8V 和3.3V 的TTL电平这个信息,MCU 的UART 是3.3V 的TTL电

平,于是就降低MCU的供电电压,变为2.8V供电,让其UART电平也在2.8V,问题就得到了解决。这个也是由于电平不兼容导致的一个问题,所以这方面的电路设计中电平兼容很重要。

案例2 设计一款带4G 功能的物联网称重仪表,4G 模块为采购物料,品牌有移远,美格,SIMCOM,移柯。但是不同品牌的4G 模块,它们的UART 电平都是很低的。以移远的EC200S 为例,UART 是1.8V的TTL 电平。而常用的MCU 单片机都是3.3V 或者5V供电,其UART 都是3.3V 或者5V的,中间串接电阻的方案不能满足其电平兼容的条件,这个压差比较大。于是就想用MOS 或者三极管搭建的电平兼容电路,这个的价格比较便宜。后来由于这款物联网称重仪表的成本空间还有余量,而且PCB 线路板空间有限,就选用了一颗两通道电平转换芯片,测试通信稳定性都是可以的。如果没有电平兼容的电路,4G 模块就一定无法与MCU 通讯,所以电平兼容的技术应用很是关键。

5 结语

本文着重强调电平兼容在物联网称重仪表中的 重要性,以及一些常用电平兼容的电路和方法。其 次就是电路中电平种类和工作中的一些案例。电平兼容是一种不可忽视的技术,面对那么多的电平兼容方法,需要对项目整体把控,在成本有余量的项目中,建议使用集成的电平转换芯片。为了降低成本的项目,则使用MOS管或者三极管搭建的电平兼容电路。物联网是称重仪表的一个发展趋势,电平兼容的重要作用,也悄然体现在每个物联网称重仪表硬件电路设计中。

参考文献

- [1] 康华光, 邹寿彬. 电子技术基础(数字部分, 第四版). 北京; 高等教育出版社, 2000:40-76.
- [2] 吉利久, 沈悌明, 等.C-MOS 电路输入级的设计—与TTL 电平兼容, 北京大学计算机系, 微处理机.1986. 第4期.
- [3] 方虎生, 芮挺, 等. 混合电压系统与板级总线逻辑电平转换, 解放军理工大学野战工程学院, 无线互联科技,2013, 第4期.
 - [4] Nadira Sultana and ChrisCockrill, Texas

Instruments Voltage—Level—Translation Devices. Texas Instruments, 2009.

[5] wS06f9589Gu7. TTL、CMOS、RS232、 RS485 的区别和联系.

https://wenku.baidu.com/view/1c9e4d97f221dd3
6a32d7375a417866fb84ac0b2.html?fr=income2-docsearch&_wkts_=1683859367883&wkQuery=TTL%E3%
80%81CMOS%E3%80%81RS232%E3%80%81RS485%E
7%94%B5%E5%B9%B3%E5%B7%AE%E5%BC%82.html,
2018.07.24.

[6] 郭天祥. 51 单片机C语言教程入门、提高、开发、拓展全攻略[M]. 北京: 电子工业出版社, 2009: 127-130.

作者简介

李虎, (1992—), 男, 本科学历, 助理工程师, 现供职于上海耀华称重系统有限公司, 从事称重仪表硬件开发工作。